

证券代码：300223

证券简称：北京君正

北京君正集成电路股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：20250420

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（_____）
参与单位名称及人员姓名	中泰证券：张琼；光大证券：孙啸；国投证券：吕众；华金证券：王海维等。
时间	2025年4月20日
方式	线上电话交流会
上市公司接待人员姓名	总经理刘强、董事会秘书张敏
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、 公司基本情况介绍</p> <p>二、 问答环节</p> <p>1、我们怎么看待行业的市场在2025年的表现，以及从季度上来看，是否会有一个逐季提升，或者哪个季度可能会有一个更好的全年表现？对于2025年行业市场的表现，以及其季度节奏的变化，我们应该如何理解？</p> <p>根据我们的观察和预测，行业市场在2025年确实存在逐步复苏的可能性。我们的模拟与互联芯片领域由于收入主要在国内，通常会受到国内淡旺季的影响，Q3和Q4表现可能较好，而Q1因春节因素环比可能会有所下降。不过，从目前的情况来看，我们预计存储芯片和模拟互联芯片在2025年第一季度市场情况都能实现同比的好转。从全球市场角度来看，存储芯片的收入更能反映全球市场的情况。我们认为2025年全球市场将从2024年的压力中逐渐恢</p>

复，特别是汽车行业有望呈现上升趋势。从第一季度的市场表现来看，无论是环比还是同比都有改善，这表明 2025 年可能是行业的一个转折点，整体形势会比 2024 年更好。我们预计行业市场不会出现爆发性增长，而是逐渐恢复。

2、关于新产品布局，特别是针对 AI 应用的 3D DRAM 产品的研发进度和收入贡献情况能否分享一下？

目前该产品还在研发阶段，我们争取今年能向客户提供样品，但具体进度取决于实际研发情况。明年可能对收入开始产生贡献的主要是新工艺的产品，3D DRAM 的具体收入情况尚难以预估。我们正在市场端与客户大量沟通了解需求，下半年对应用场景应该会有更明朗的判断。

3、公司规划的高算力 SoC 产品将达到什么级别，价格带会是什么区间？以及可能的应用终端方向有哪些？

目前我们的算力主要在 IPC 市场应用，多在 1 个多 T，能满足目前 IPC 市场的主流需求。预计年底推出的 T42 能达到 2T 以上，未来几年将持续加大算力投入。在终端应用方面，目前看到的机会是在 NVR（网络视频录像机）领域，特别是对于大算力、AI 模型的需求，例如海康威视已在该领域推出相关产品。整体而言，我们在视频产品线上的算力提升方向包括在 IPC 上提高至 2T 或 4T，以及在 NVR 领域提供 8T 至 16T 级别的算力支持。

4、3D DRAM 在搭配 NPU 或 SoC 时，会采用什么样的搭配方式？是自家的大算力 SoC 还是合作伙伴的产品？

3D DRAM 目前需求升温，主要是由于 HBM 存在对中国禁运的风险，而 3D DRAM 通过 hyper band 绑定能更高效地提供带宽和功耗。目前工业界都在尝试这一方向，而大算力芯片方面，大型互联网公司在积极尝试，包括 AI PC、手机端和 AIoT 端也有类似尝试。关于 3D DRAM 的具体搭配方式，我们会根据市场需求和技术发展进行优化，但目前尚未确定具体的合作伙伴或产品形式。

5、关于最近热议的关税问题，它对我们 DRAM 产品线和模拟产品线的影响是什么？公司产品会涨价吗？

关税确实对我们两条产品线都有影响。对于 DRAM 产品线，由于美系厂商的部分生产基地在美国，可能会受到关税影响；对于模拟产品线，因中国增加芯片原产地关税，也有类似的问题，目前看来，这会促进国内芯片厂商的销售和价格稳定性。

6、关于 3D 堆叠 DRAM 方案的技术难点和壁垒主要体现在哪些方面？

3D 堆叠 DRAM 方案的核心技术难点在于堆叠工艺，尤其是如何将两层、四层、六层乃至更高层次堆叠在一起。此外，设计公司还需要解决冗余性、修复机制、ECC 校验算法与主控芯片和算力芯片结合的问题，以及考虑到芯片尺寸较大带来的散热问题等工程要点。

7、计算类芯片随着算力增大，主要解决什么样的技术问题？

随着算力增大，对计算类芯片特别是端侧 AI 芯片的需求增加，主要解决的是数据安全性问题，即在某些场景下，用户希望数据不上传到云端而在本地运行大型模型。目前 PC 端已有企业对此有明确需求，同时 NVR 领域也开始推出能够运行大模型的产品。因此，大模型在端侧的应用需要强大的算力、高带宽和大容量存储空间，而 3D 堆叠 DRAM 或类似技术可以提供一个有效的解决方案。

8、公司现在研发团队的布局是怎么样的？

我们现在的研发团队在全球多地有布局，包括美国、以色列、日本和韩国等国外地区，以及国内的北京、上海、合肥、武汉和厦门等地。

9、公司去年的股权激励计划是否可以行权，以及未来是否有新的激励计划推出？

今年公司已经达到行权条件了。根据实际情况，如果合适的话，我们后续也可能会推出新的激励方案。

10、未来三五年公司整体的战略规划方向是什么？

我们现在产品面向的几个领域都是市场发展空间很好的赛道，未来我们将延续现有的战略方向，大力发展现有的几条产品线。同时，公司也会推动大算力芯片的研发、3D DRAM 产品的研发，加

	强在 AI 领域的布局，同时，加快新工艺 DRAM 产品的迭代，以支持公司未来三五年持续增长。
附件清单(如有)	无
日期	2025 年 4 月 20 日